



台積公司宣布有意於美國設立先進晶圓廠

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2020年5月15日

台積公司今(15)日宣布在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其支持下，有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠。

此座將設立於亞利桑那州的廠房將採用台積公司的 5 奈米製程技術生產半導體晶片，規劃月產能為 20,000 片晶圓，將直接創造超過 1,600 個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。該晶圓廠將於 2021 年動工，於 2024 年開始量產。

2021 年至 2029 年，台積公司於此專案上的支出（包括資本支出）約 120 億美元。此先進晶圓廠不僅能使台積公司為客戶和夥伴提供更好的服務，也為台積公司提供了更多吸引全球人才的機會。此專案對於充滿活力及具有競爭力的美國半導體生態系統來說具有重要的策略性意義，它使具業界領先地位的美國公司能於美國境內生產其最先進的半導體產品，同時又能受惠於世界級的半導體晶圓製造服務公司及其生態系統的地理鄰近性。

台積公司期待與美國當局及亞利桑那州於此專案上繼續維持鞏固的夥伴關係，此專案需要台積公司大量的資本和技術投資，而美國強健的投資環境及其優秀的人才使得此專案及未來於美國的投資對台積公司來說極具吸引力。美國採行具前瞻性的投資政策為其業界領先的半導體技術營運創造出具全球競爭力的環境，此環境對於本專案的成功至關重要。這也使台積公司對此項投資及未來與其供應鏈夥伴投資的成功皆充滿信心。

台積公司目前在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖何西市皆設有設計中心。此座位於亞利桑那州的廠房將成為台積公司在美國的第二個生產基地。



關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2019 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 272 種製程技術，為 499 個客戶生產 1 萬 761 種不同產品。台積公司為世界首家提供 5 奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。

進一步資訊請至台積公司網站 www.tsmc.com.tw 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

孔培德
公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5031
Mobile: 0988-931-352
E-Mail: pdkramer@tsmc.com